

課題番号 : F-18-TU-0115
利用形態 : 技術相談
利用課題名(日本語) : MEMS デバイス開発
Program Title (English) : Development of MEMS device
利用者名(日本語) : 松尾雄祐¹⁾
Username (English) : Y. Matsuo¹⁾
所属名(日本語) : 横河電機株式会社
Affiliation (English) : Yokogawa Electric Corporation
キーワード/Keyword : 接合、パッケージング

1. 概要(Summary)

弊社開発の新規センサ量産化プロセスについて、東北大学試作コインランドリに技術相談を行った。

目的とする低融点ガラスを接合層に用いた接合の条件について、詳細を打合せした。その結果、温度制御および荷重制御を適切に行うことにより、溶剤の揮発および接合を確実にできる可能性を見出すことができた。現状チップレベルプロセスであった低融点ガラス接合プロセスにおいて、ウェハレベルプロセス化の実現へ近づいたものと考ええる。

実際に東北大学所有ウェハーボンダー Suss SB6e を用い、接合強度の評価は実施出来ていないものの、ダミーウェハ同士の低融点ガラス接合に成功した。

今後は同装置を用いて、実サンプルでの接合実験や、最適な接合条件の調査を実施する予定。

2. 実験(Experimental)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

3. 結果と考察(Results and Discussion)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

4. その他・特記事項(Others)

なし。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。